

## 参考資料3 プロジェクト全体に対するコメント

「半導体アプリケーションチッププロジェクト（情報家電用半導体アプリケーションチップ技術開発）」終了後に、本制度自体に対する制度評価が実施される。この制度評価（事後評価）の参考となる基礎情報とするため、制度やテーマ推進全般、及びそれに係わるNEDOのマネジメント等、プロジェクト全般に対する評価委員のコメントを以下に列記する。

#### <評価委員コメント>

今回の報告事例から判断して、アプリケーションチップを一括りにするのではなくその中でもニーズ指向とシーズ指向を分けて採択、評価することが必要であろう。

今回も、一部の報告で日本の設計・試作のインフラの弱さ（大企業の都合に左右されやすい試作環境、米国に対し見劣りする試作環境・信用度）が見られ、改善の必要性がある。

事業化の体制において大きなバラツキがみられるが、これは当初からある程度予測されたはずである。NEDOとして組織的支援の体制整備が重要であろう。

この分野は日本の製造技術と応用・事業化への「つなぎ」として重要な部分であり、国力相応規模の継続的施策を期待したい。

論文・特許・プレスリリースなどによる研究成果の公表に関して、プロジェクト間での温度差がかなりあるように見受けられる。特に、特定企業の内部的な製品戦略と密接に関わっている場合、成果を積極的には公表したくない雰囲気があるように思われる。途中結果も含む成果公表に関して、NEDOが積極的に関与（公表の機会を頻繁に設けるとか、ノルマを設けるなど）する必要があるのではないか。

マルチコアのようにメインストリームな技術領域の課題にチャレンジしたテーマ、TOF CMOS 撮像チップのように新しいアイデアに基づく機能や性能の実証を目指したテーマ、製品化の前の試作チップ実証を目指したテーマなどと目標の異なるテーマが混在した意義あるプロジェクトと理解する。また日本ではなかなか育たないファブレスベンチャー向けにこのような試作支援的なプログラムがあるのは良いのではと感じる。

各々のプロジェクトにおいて、技術そのものは、深く掘り下げが出来ており、当初の目標は達成されているように、報告書はまとめられている。しかし、実際の事業化の観点からは、どうしても『プランの稚拙さ』がみえてしまう。

昨今、技術系大学においてMOTやTLOの活動も活発化しているが、日本の大学では、欧米に比べると『事業化』という結果が極端に少ない。また、技術系ベンチャー企業や、

企業の研究開発部門でも同じ傾向にある。そこで、プロジェクト期間中、『事業化』を専門とする企業にアドバイザーとしての派遣サポートを依頼するシステムを提案したい。

プロジェクトによって実用化の時期が様々であり、ひとつの基準で選択評価するのは困難。基礎開発フェーズ、実用化開発フェーズの2部門に分けてはどうか。

また、採択されたプロジェクトについては、我々委員が事業化の方向性に関するアドバイスを与える機会を設けたい。

一定期間以内に事業化されないプロジェクトについては成果をオープン化するなど、開発した技術の有効利用を促進すべき。